

新製品紹介

1.0 mm 厚 超薄型ヒートパイプ

近年、ノートパソコン、携帯電話に代表される携帯型電子機器の小型化、薄型化、高性能化の要求は目覚しく、薄型ヒートパイプを用いた冷却システムが必須となっているが、これまでのヒートパイプ構造では要求される薄型化に対応することが難しくなっていた。

今回開発した超薄型ヒートパイプは新しい内部構造により、これまで実現不可能であった厚さ1 mmで、10 W以上の熱量を輸送することが可能となった。この超薄型ヒートパイプを使用することにより、これまで適用を制限されていた Ultra Mobile Personal

Computer (UMPC) や薄型電子機器、携帯電話などへの搭載も期待されている。

特徴

- ・従来品に比べ、熱輸送量、熱抵抗が大幅改善
- ・携帯電話・薄型電気製品への採用可能
- ・メンテナンスフリー
- ・ランニングコストフリー

(サーマルテック事業部開発部 堀内)

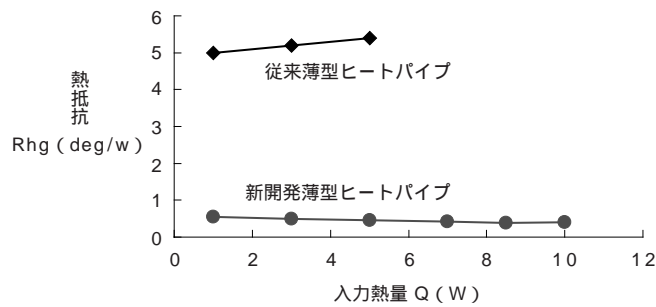


図1 熱性能比較



図2 携帯電話への応用例



図3 UMPCへの応用例



今回開発した超薄型ヒートパイプ

[お問い合わせ]

サーマルテック事業部技術部

TEL : 03-5606-1174 FAX : 03-5606-1514

E-mail : netsue-info@fujikura.co.jp